

EDITORIAL

ProPower 1785

VERBÄNDE



FBDi - Informationen

1819



FED - Informationen

1837



ZVEI: - Informationen
Die Elektroindustrie

1868



MAPS - Mitteilungen

1903



3-D MID - Informationen

1926



DVS - Mitteilungen

1970

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 1788

Neue Normen 1800

Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1801

BAUELEMENTE

Distributor mit aktuellen Programmergänzungen 1806

HY-Line optimiert die Leistungselektronik 1810

Hohes Tempo der Produktinnovation
und schnelle Lieferung vereinen sich bei TDK 1812

DESIGN

Apple-Patente für automatische Lautstärkeregelung
und Energieverwaltung beim Handy 1823

LabVIEW 2013 vereinfacht Systementwürfe und ermöglicht
die Entwicklung hochmoderner Technologien 1827

Design Content für EFM32-Gecko-MCUs 1829

Simulation der Qualität von elektrischen Signalen, Strom-
und Spannungsversorgung 1830

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit)
Kupfer – die Basis der Elektronik 1843

Die globalen Top-100-Leiterplattenhersteller 2012 1846

Hochpräzise Stromsensoren für die Leiterplattenmontage 1856

Wirksame wie wasserbasierte Reinigungsprodukte 1858

Kontinuierliche Erweiterung der Juki-Produktpalette 1859

Mit drei Leiterplatten auf die Ziellinie – ein Trainingssystem
erlaubt virtuelles Radfahren 1860

ETS nutzt eigene Fertigungsbasis in China
für den europäischen Markt 1864

BAUGRUPPEN & SYSTEME

LXI-System zur Signalüberwachung
der Teilchenbeschleuniger am CERN 1877

Stets zur Stelle – automatisierter Bote
bietet 24-Stunden-Dienst 1882

EN-9100-Zertifizierung, Technologietag und neues
Equipment – Eltroplan wappnet sich für die Zukunft 1886

Funktionelle Oberflächen und Beschichtungen im Fokus
des 5. Berliner Technologieforums 1890

Koenen – 45 Jahre Präzision im Siebdruck 1893

Pac Tech erweitert Ressourcen sowie Produkt-
und Dienstleistungsportfolio 1898

Neue Mainboard-Familie mit vierter Generation
der Intel-Core-Prozessoren 1902

ANALYTIK & TEST

Boundary Scan Days 2013 – Zusatztechnologien
im Kommen 1918

Präzise und effektive Qualitätssicherung
mittels 3D-Digitalmikroskop 1922

Rework & Inspection Workshop der SMART Group 1923

Dynamische Fehleranalyse 1924

Quad-Core PXI-Embedded-Controller erledigt
komplexe Testaufgaben 1925

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Aufbau- und Verbindungstechnik leistungselektronischer
Module und Baugruppen 1930

Silber-Sintertechnologie im Verbundprojekt ‚ProPower‘ –
neue Materialien, Prozesse und Prüfverfahren 1937

Herstellung freigestellter Ag-Sinterschichten
mit unterschiedlichen Porositäten zur Charakterisierung
mechanischer Kennwerte 1950

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Modellierungsansatz zur thermomechanischen Analyse von gesinterten Halbleiterbauelementen in der Leistungselektronik	1957
Patente	1964

FORUM

Microelectronics Saxony – Forschen in die Zukunft	1972
REACH – Pflichten zur Information bei Verwendung von SVHC-Stoffen	1981

Branchenreport Photonik 2013 – Zustand und Perspektiven der Photonikindustrie	1986
Kolumne – Anders gesehen: Lotmelange	1989
PLUS-Firmenverzeichnis	1991
Firmenindex	2016
Stellenmarkt und Kleinanzeigen	2019
Inserentenindex	2021
Anzeigenformate und Preise	2022
Impressum	2023
Produkt des Monats	2024

Titelbild: Die LeitOn GmbH wurde 2004 gegründet und ist mit ca. 45 Mitarbeitern auf die Herstellung von Leiterplatten spezialisiert. Seit 2006 gibt es neben dem Hauptsitz in Berlin auch eine Niederlassung in Hongkong, um Handelswaren, Audits und Qualitätskontrollen in China abzuwickeln. LeitOn bietet ein umfassendes Spektrum an verschiedenen Technologien, Dicken, Kupferauflagen und Materialien für Hochleistungsansprüche. Das Portfolio der Firma geht vom 12-Stunden-Prototypen aus Deutschland bis zur Großserie aus Asien. Vieles davon ist sogar online kalkulierbar: Expressprototypen, Dickkupfermultilayer bis 8 Lagen, mittlere Serien, Aluplatinen, flexible Leiterplatten und SMD-Schablonen.

www.leiton.de

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente Distribution e.V.,
Tel. +49/8165/670233,
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de



Fachverband Electronic Components and Systems
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251,
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org



Fachverband Elektronik-Design e.V.,
Tel. +49/30/8349059,
info@fed.de, www.fed.de



Fachverband PCB and Electronic Systems
Tel. +49/69/6302-437,
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY – Deutschland e.V.,
Tel. +49/3677/69-3381,
martin.schneider-ramelow@imaps.de,
www.imaps.de



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49/91 1/5302-9100,
info@3dmid.de, www.3dmid.de



European Interconnect Technology Initiative e.V.
Tel. +49/69/6302-281,
eiti@zvei.org, www.eiti.org



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49/211/1591-0,
michael.weinreich@dvs-hg.de,
www.dvs-ev.de

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.